

5Gインパクトに対応するFPC新技術とその市場動向

講師: 松本 博文氏(日本メクトロン株式会社 フェロー/上席顧問)

既に海外では開始した「5G」の商用サービス、国内でも2019年9月にはプレサービスがよいよ開始する。これらの「5Gシフト」によりスマートフォン、自動車、メディカル(ヘルスケア)への種々のサービスや製品が大変革し創生される(5Gインパクトとも呼ばれる)。5G新商品、新サービスの出現はあらゆる産業を変革すると共に我々の生活様式まで変える可能性がある。

それらの5G新商品に応用されるFPCも「高周波対応」、「高精細化」、「伸縮性」、「透明性」などFPC機能向上のための新材料・新プロセス開発とその応用展開が急務になっている。特に2019年に発売開始した5G対応スマートフォンに応用するFPC技術によるアンテナや伝送路の高速化は最重要課題とされている。ウェアラブルFPCやセンサFPC開発も不可欠だ。本講演では、これらのFPC機能性向上に対する技術課題と技術開発動向を詳細に解説する。

【経歴】日本メクトロン(株)入社以来、FPC技術畑に携わる。設計、海外技術サービス、技術開発を経て2003年取締役就任。2007年商品企画室の取締役 室長、2011年執行役員マーケティング室 室長としてFPC新製品企画、技術開発企画、技術マーケティングを推進。現在、該社のフェロー/上席顧問に従事している。米国ノースウェスタン大学機械工学科博士課程卒。

【活動】エレクトロニクス実装学会(JEIP)常任理事 展示会事業委員長 兼 技術調査事業副委員長、エレクトロニクス実装学会 配線板製造技術委員会委員、エレクトロニクス実装学会マイクロナノファブリケーション研究会委員、ECWC(電子回路世界大会)WG委員、POLYTRONICS(ポリトロンクス)学会組織委員、インターネブコン プリント配線板 EXPO 専門技術セミナー企画員、JPCA 統合格部会 委員、JPCA 展示会企画・運営委員会 委員

開催日時	2019年7月11日(木) 10:30~16:30	【会場】	ちよだプラットフォームスクウェア 5F 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-21
受講料	45,000円(税込) ※資料・昼食付 * メルマガ登録者 40,000円(税込) * アカデミック価格 25,000円(税込)		

*アカデミック価格:学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限ります。

★【メルマガ会員特典】2名以上同時申込で申込者全員メルマガ会員登録をしていただいた場合、2名目は無料、3名目以降はメルマガ価格の半額です。

【本セミナーのプログラム】

※適宜休憩が入ります。

1. FPCの基礎とグローバル市場動向

- 1-1 FPCの基礎
- 1-2 最新電子部品マクロトレンド
- 1-3 FPC市場/用途動向

2. 5Gインパクトで要求されるFPC新技術とは?

- 2-1 5Gインパクトと新電子サービスの拡大
- 2-2 5Gマクロトレンドと関連FPCトレンド

3. 最新スマートフォン技術動向とFPC技術課題

- 3-1 スマートフォン市場動向と新機能変遷
 - 3-1-1 グローバル・スマートフォン市場動向
 - 3-2-2 スマートフォン新機能動向
 - 3-2-2-1 5G折り畳みスマホ動向
 - 3-2-2-2 5Gアクセサリ(MRグラス、スマートリング、無線イヤホン)動向
- 3-2 スマートフォンディスプレイ技術動向
 - 3-2-1 AMOLEDとLCD技術動向
 - 3-2-2 Mini/Micro LED技術動向
- 3-3 5GスマートフォンへのFPC新技術
 - 3-3-1 スマートフォン送受信仕組み
 - 3-3-2 スマートフォンアンテナ技術と高速FPC応用
 - 3-3-3 AIP(アンテナ・イン・パッケージ)とFPC技術

4. 高速(高周波対応)FPC技術開発

- 4-1 5Gに応用する高速FPC市場/技術動向
- 4-2 LCPを応用する高速FPC開発
- 4-3 MPI(Modified PI)を応用する高速FPC開発
 - 4-3-1 フッ素化ポリマー(PTFE、PFA)ハイブリッドMPI開発
 - 4-3-2 LCP・MPI以外の高速FPC材料技術開発
- 4-4 高周波対応銅箔開発(低導体損失/表皮効果対応)
- 4-5 高速FPCに必要な種々評価技術

5. 高精細(ファインピッチ)FPC技術開発

- 5-1 配線微細化動向と対応技術開発比較
- 5-2 SAP(セミアデティブ)技術比較

6. 進化する車載用FPC技術開発

- 6-1 車載用FPCの市場動向
- 6-2 5Gに向けた車載用FPC技術動向

7. 5G対応ウェアラブル機器への新FPC技術開発

- 7-1 5Gヘルスケアに応用する伸縮FPC技術
- 7-2 フレキシブル触覚センサモジュール技術
- 7-3 透明FPC技術とその応用技術
- 7-4 フレキシブルエレクトロニクス応用技術

8. まとめ

弊社記入欄		セミナー申込書	
セミナー名		5Gインパクトに対応するFPC新技術とその市場動向	
所定の事項にご記入下さい メルマガ会員、登録希望の場合は○↓		会社名(団体名)	TEL:
		住所〒	FAX:
			E-mail:
会員登録済み	新規登録希望	部署	役職
お支払方法		銀行振込・その他	氏名
			お支払予定
			2019年 月 日頃

■申込方法: セミナー申込書にご記入の上 FAX または E-mail(re@cmcre.com)でお申し込みください。

■セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりません、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

■申込先: (株)シーエムシー・リサーチ 東京都千代田区神田錦町 2-7 TEL 03-3293-7053

■本セミナーの関連情報は、弊社HPでもご覧になれます。⇒ <http://www.cmcre.com>

参加申込 FAX 番号
03-3291-5789